

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2022-020

## 合肥芯碁微电子装备股份有限公司

### 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金部分投资项目“高端PCB激光直接成像（LDI）设备升级迭代项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

#### 一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥芯碁微电子装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]350号）的批准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,020.2448万

股，募集资金总额人民币 459,983,283.04 元，募集资金净额为人民币 416,358,195.95 元。上述资金已于 2021 年 3 月 29 日全部到位，并存放于公司开设的募集资金专项账户内。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具《合肥芯碁微电子装备股份有限公司验资报告》（容诚验字【2021】230Z0034 号）。

## **二、首次公开发行股票募集资金存放及管理情况**

为规范公司募集资金管理，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规要求，公司开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构海通证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司已于 2021 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

## **三、募集资金投资项目的情况**

由于公司首次公开发行实际募集资金净额少于拟投入的募集资金金额，公司召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》（具体详见公司于 2021 年 4 月 8 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》），经调整后，公司本次发行募集资金投资项目情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	调整前拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
1	高端 PCB 激光直接成像（LDI）设备升级迭代项目	20,770.00	20,770.00
2	晶圆级封装（WLP）直写光刻设备产业化项目	9,380.00	5,880.00
3	平板显示（FPD）光刻设备研发项目	10,836.00	8,630.82
4	微纳制造技术研发中心建设项目	6,355.00	6,355.00
	合计	47,341.00	41,635.82

#### 四、本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为“高端 PCB 激光直接成像（LDI）设备升级迭代项目”。截至 2022 年 3 月 31 日，该项目已基本完成投资，产线及设备已达到可使用状态并投入使用。

##### （一）本次结项募集资金专户存储情况

本次结项募集资金投资项目“高端 PCB 激光直接成像（LDI）设备升级迭代项目”，截至 2022 年 3 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	开户银行	银行账号	尚未使用的募集资金金额
高端 PCB 激光直接成像（LDI）设备升级迭代项目	上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行	58060078801900000917	6,825.18

##### （二）本次结项项目募集资金节余情况

截至 2022 年 3 月 31 日，本次结项项目募集资金使用情况以及节余情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	募集资金拟投资总额	累计投入募集资金金额	利息收入扣除手续费后净额	尚未使用募集资金金额
高端 PCB 激光直接成像 (LDI) 设备升级迭代项目	20,770.00	14,358.48	413.66	6,825.18

注：募集资金预计剩余金额未包含尚未收到的银行利息收入，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。

## 五、募集资金节余主要原因

截至 2022 年 3 月 31 日，“高端 PCB 激光直接成像 (LDI) 设备升级迭代项目”预计投入与实际投入差异情况如下：

单位：人民币万元

项目	预计投入	实际投入	完成比例
场地建设投资	5,380.00	9,832.91	182.77%
设备投资	10,446.00	1,316.73	12.61%
软件投资	220.00	267.00	121.36%
预备费投资	802.00		0.00%
铺底流动资金	3,922.00	2,941.84	75.01%
合计	20,770.00	14,358.48	69.13%

项目集资金节余主要原因如下：

（一）场地建设为政府代建，整体开票，场地建设投资包含部分动力设备，导致场地建设投资支出加大、设备投资减少。

（二）为了节约成本，部分设备采取自制，节约了设备投资金额。

（三）本募投项目所需的部分生产和研发设备自 2019 年初至今市场售价呈下降趋势，进一步节约了设备购置费用。

（四）在募投项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，加强项目建设各个

环节费用的控制、监督和管理，通过生产线相关设备维修重复利用等方式，合理降低了设备总支出。

（五）募集资金在存储过程中产生了利息收入和现金管理投资收益。

## **六、节余募集资金的使用计划**

“高端 PCB 激光直接成像（LDI）设备升级迭代项目”已基本完成投资，产线及设备已达到可使用状态，目前产品已发货到相关客户。为提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，提升经济效益，公司拟将节余募集资金人民币 6,825.18 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

## **七、专项意见说明**

### **（一）独立董事意见**

独立董事认为：公司首次公开发行股票部分募投项目“高端 PCB 激光直接成像（LDI）设备升级迭代项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金，将进一步充盈公司主营业务的现金流，有利于公司主营业务发展、提高公司资金利用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司或股东利益的情形。

该事项的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股

票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事同意《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》所审议的事项。

## **（二）监事会意见**

监事会认为：本次公司首次公开发行股票部分募投项目“高端PCB激光直接成像（LDI）设备升级迭代项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，有利于进一步充盈公司主营业务的现金流，提高募集资金使用效率，提高盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，公司监事会同意《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》所审议的事项。

## **（三）保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司首次公开发行股票募投项目“高端PCB激光直接成像（LDI）设备升级迭代项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上

海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，符合全体股东的利益。保荐机构对公司首次公开发行股票募投项目“高端PCB激光直接成像（LDI）设备升级迭代项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司

董事会

2022年4月28日